

## 「エレクトロニクス開発・実装展」に出展

株式会社東海理化(本社：愛知県丹羽郡大口町、代表取締役社長：二之夕 裕美)は、5月14日(水)から5月16日(金)までインテックス大阪にて開催される「エレクトロニクス開発・実装展」(第1回 [関西] ネプコン ジャパン - エレクトロニクス開発・実装展)に出展します。

当社は「人が手掛けないことこそやる」の創業精神のもと、自動車部品業界で培われた技術で事業を拡大してきました。自動車部品に組み込む半導体を自社工場で製造しており、累計5億個の生産実績があります。2023年度からは半導体外販\*を進めています。

※中期経営計画目標の実現と、将来の成長に向けた挑戦を加速させる『未来創造投資』案件の一つ

### ◇主な展示品

#### ・磁気センサ製品

自社工場で製造したAMRセンサを搭載した回転角センサ、近接センサを展示。これらは自社の自動車部品に組み込まれる形で使用されている高精度・高信頼性のセンサです

#### ・カスタムIC製品

お客様のニーズに合わせてカスタムICの設計・製造が可能。アナログ・デジタル・ミックスドシグナルと幅広いICに対応可能。また、センサ信号を増幅・処理するためのAFE ICやモータ・LEDを駆動するドライバICの経験が豊富です。

⇒ [センサ製品・カスタムICの紹介パネル](#)



### ◇出展場所

インテックス大阪 6号館 K2-40

⇒ [会場地図](#)

### ◇来場登録サイト

<https://www.nepconjapan.jp/osaka/ja-jp/register.html?code=1335004046655307-LFQ>

※来場には来場事前 登録(無料)が必要になります。来場登録は上記 URL より申し込みください。

【半導体 URL】 <https://tr-semicon.tokai-rika.co.jp/>

【本件に関するお問い合わせ先】 株式会社東海理化 総務部広報室 (0587-95-5211)